

**EVG demonstrates hybrid bonding and nanolithography imprinting solutions at SEMICON Taiwan 2023 – September 5, 2023**

**EVG在SEMICON Taiwan 2023展示混合键合与纳米微影压印解决方案**

- 林佩莹／台北讯
- 2023-09-06

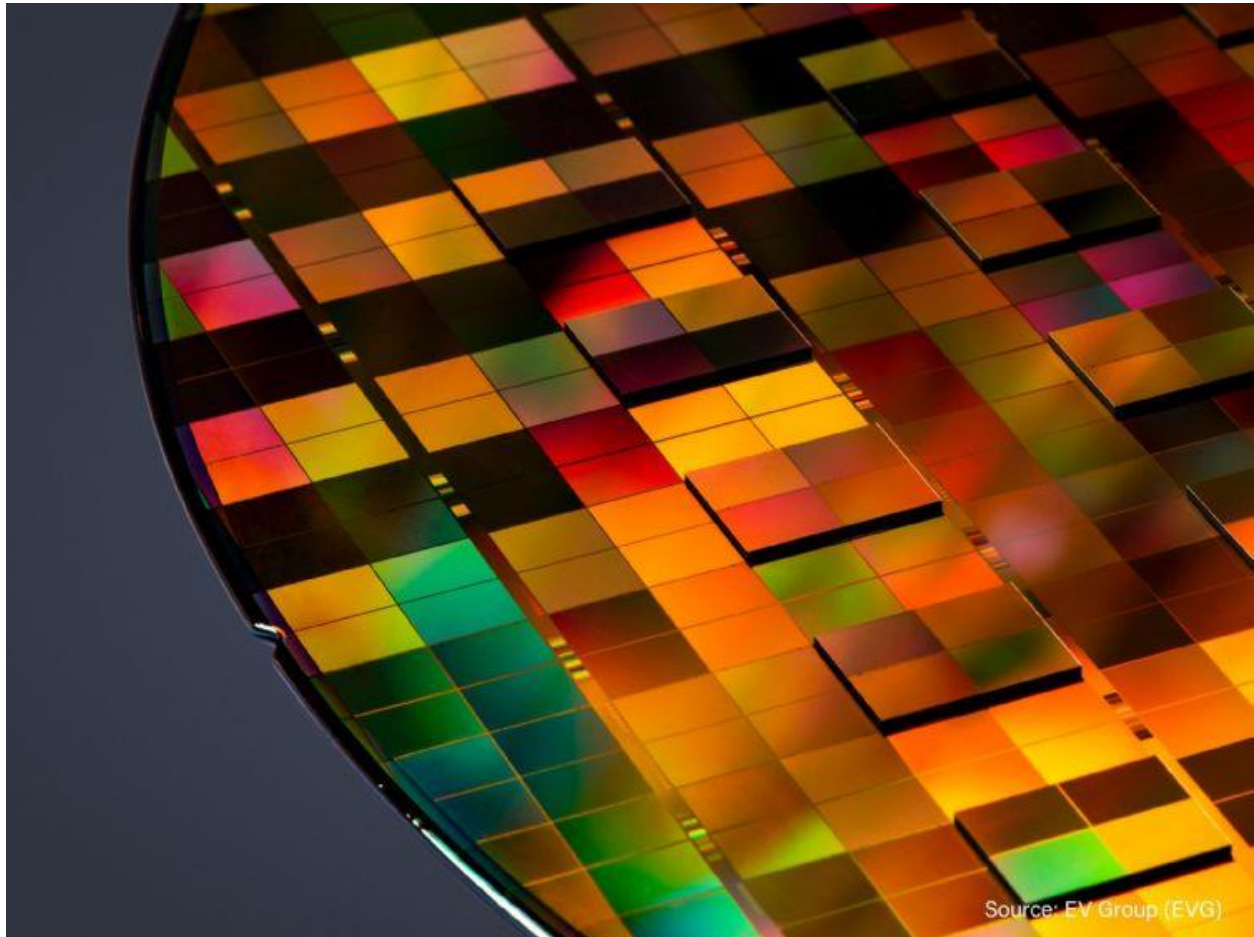


EVG BONDSCALE 300 mm system。EVG

在SEMICON Taiwan 2023国际半导体展中，EV Group（EVG）将重点介绍由该公司先进之晶圆到晶圆（W2W）与晶粒到晶圆（D2W）混合键合、检测与纳米微影压印（NIL）解决方案所带来的3D整合和异质整合与增实境（AR）波导制造领域的全新发展。

EVG在2023年的展会论坛上将深入探讨以下主题：首先，在「微机电暨传感器论坛」（9月5日，周二下午2点，台北南港展览馆一馆5楼505ab室），EVG将分享纳米微影压印的多功能性与最新成就，并聚焦于超

颖透镜和增实境/虚拟实境技术的制造，以及这项技术能力的迅速崛起。其次，在「TechXPOT」（9月6日，周三下午2点，台北南港展览馆一馆4楼L1100摊位），EVG将介绍目前各种应用中对堆叠层计量要求，涵盖从晶粒到晶圆、晶圆到晶圆，以及新型封装技术中的晶粒位移的困扰等，例如具有适应性图案化的无光罩曝光设备。



EVG - D2W晶粒到晶圆。EVG

此外，在「半导体先进制程科技论坛」中（9月8日，周五下午2点，台北南港展览馆一馆4楼402室），EVG将对次时代存储器和逻辑装置相关的当前产业趋势进行分享，重点聚焦3D整合如何实现新技术进步。最后，在「异质整合国际高峰论坛」上（9月8日，周五下午2:20，台北南港展览馆一馆4楼401室），EVG将讨论晶圆到晶圆和晶粒到晶圆混合接合的当前产业趋势和技术进展，包括关键的技术差异和整合场景。

EVG的晶圆接合、微影与检测解决方案，使得先进封装、微机电系统(MEMS)与化合物半导体等领域中技术创新的开发和大规模制造成为可能。EVG在异质整合和芯片级封装方面的技术领导地位包括：混合键合技术应对3D装置整合；晶圆接合对准技术应对未来3D-IC封装需求的；红外线雷射释放技术消除先进封装中

的玻璃基板并实现薄层3D堆叠；无光罩曝光技术应用于扇出成型晶圆级封装（FOWLP）；以及纳米微影压印技术支持芯片级光学元件（WLO）制造。

欢迎莅临SEMICON Taiwan 2023国际半导体展参观EVG摊位L0316（一馆4楼），以获取更多相关信息。

[https://gb-www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=13&id=0000672504\\_PD6IL9OLM1ZP85A0D8EP&cat=10](https://gb-www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?cnlid=13&id=0000672504_PD6IL9OLM1ZP85A0D8EP&cat=10)